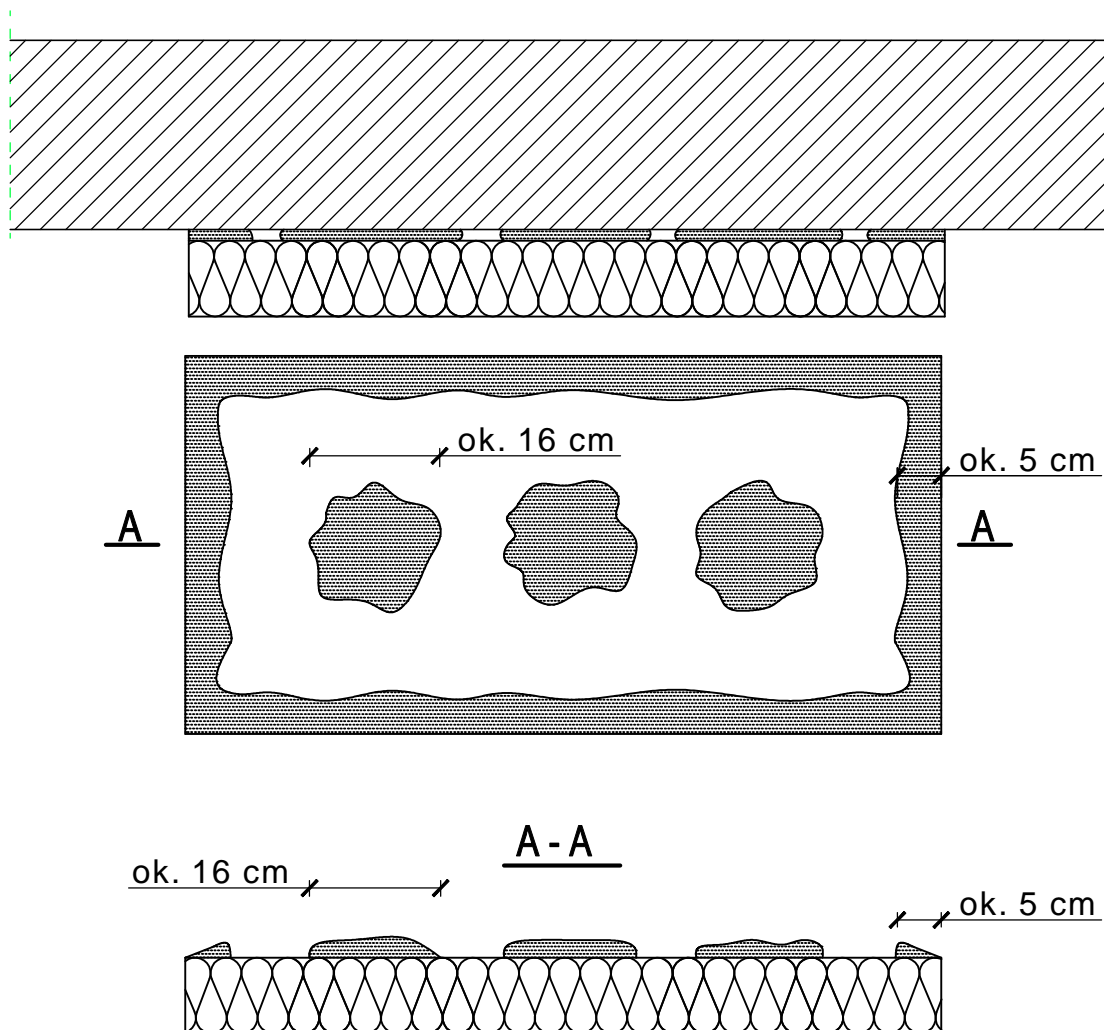


Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% / 40 \%$$

P_e – efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

P – powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwe i drewnopochodne, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

OBIEKT	Wyższe seminarium duchowne		
TEMAT	Projekt ocieplenia budynku		
ADRES	Radom ul. Młyńska 23	Stadium P.B.	
TREŚĆ OPRAC.	Detal – sposób klejenia płyt		
Projektował	mgr inż.arch.Mściżniew Marcinia BL-POKK/03/2002 MA-1535		Data 12.09
Inwestor	Wyższe Seminarium Duchowne 26-610 Radom ul.Młyńska 23		Skala 1 : 10 Nr rys. 7